

### Lagenaufbau

Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1	Cu+galv.Cu		18+25	
	Prepreg	0.109		2116
	Prepreg	0.109		2116
2	Cu	0.36	35	
	Tr-Lam		35	
3	Cu			
	Prepreg	0.109		2116
	Prepreg	0.109		2116
4	Cu	0.36	35	
	Tr-Lam		35	
5	Cu			
	Prepreg	0.109		2116
	Prepreg	0.109		2116
6	Cu+galv.Cu		18+25	

Presslingsdicke *	1,52	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske *	1,63	+/- 10%

### Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- \* Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

### Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm
	Viapad-Ø	≥ 500 µm
Leiterbild Außenlagen	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	<b>Standard</b> Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
Leiterbild Innenlagen	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 200 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 260 µm
Leiterbild Außenlagen	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
<b>Standard</b>	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 85 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 100 µm